

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年4月20日(2006.4.20)

【公表番号】特表2006-507105(P2006-507105A)

【公表日】平成18年3月2日(2006.3.2)

【年通号数】公開・登録公報2006-009

【出願番号】特願2003-567551(P2003-567551)

【国際特許分類】

B 01 D 69/00 (2006.01)

【F I】

B 01 D 69/00

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月1日(2006.2.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

マイクロ流体システム(100)用の抗菌フィルタ(105)を作製するための方法であり、

基板(21)を提供する工程、

基板上にフィルタ材料(201)を形成する工程、および

マスキング技術によってフィルタ材料に複数の穴(218)を形成する工程を含む方法であって、前記マスキング技術が、

フィルタ材料に複数のスペーサ(214)を提供する工程を含み、フィルタ材料と接触する各スペーサが、マスク材料(215)における単一の穴に対応し、

前記マスキング技術がさらに、

スペーサの周囲にマスク材料(215)を提供する工程、

スペーサを取り除き、それによって、マスク材料に複数の穴(222)を形成し、かつマスク材料の穴(222)の領域のフィルタ材料(201)における穴(218)を処理する工程、および

フィルタ材料の少なくともいくつかの穴を露出するために、基板の少なくとも一部を取り除く工程を含む、方法。

【請求項2】

フィルタ材料(201)を形成する工程が、

予め定められた基板(211)の深さにフィルタ材料を拡散させる工程を含み、基板(211)内へのフィルタ材料の拡散の予め定められた深さが、フィルタ材料(201)の予め定められた厚さに相当する、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

フィルタ材料(201)を形成する工程が、

基板(211)上にフィルタ膜を堆積させる工程を含む、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

スペーサ(214)を取り除く工程が、

スペーサ(214)を溶解することを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項5】

マスク材料の穴(222)の領域のフィルタ材料(201)における穴(218)を処

理する工程が、マスク材料の穴（222）の領域のフィルタ材料（201）をエッチングすることを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項6】

フィルタ材料の穴（218）の間でフィルタ材料（201）に抗菌コーティングを堆積させる工程をさらに含む、請求項1に記載の方法。

【請求項7】

抗菌コーティングが銀を含む、請求項6に記載の方法。

【請求項8】

処理する工程が反応性イオンエッチングを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項9】

スペーサがフィルタ材料に均一に分散される、請求項1に記載の方法。